

# 江苏先锋精密科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：先锋精科

证券代码：688605

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）                                                                                                                                                                                                                      |
| 参与单位名称        | 2026年3月5日：太保资产、摩根基金、华宝基金、广发基金、景顺长城基金、中银基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 时间            | 2026年3月5日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 地点/方式         | 上海市浦东新区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、副总经理：XU ZIMING；董事、董事会秘书：XIE MEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、公司介绍基本情况</b></p> <p>公司是国内半导体设备关键精密零部件的供应商，于2024年12月12日在上海证券交易所科创板上市。上市以来公司坚持高质量发展战略，进行了产能布局、团队整合、新品研发及业务版图开拓等工作。</p> <p>在产能布局方面，在原有先锋制造一厂及表处中心的基础上，2025年公司第二表处中心（靖江先捷）新建产线项目及部分技改升级项目已投产；新建的先锋制造二厂已完成竣工验收。如果投入设备、员工等后达到满产，公司在靖江的产能预期可增加至18-20亿元。无锡先研募投项目依照计划已于2025年第一季度启动建设，2025年10月封顶，预计2026年下半年可交付使用，满产状态能为公司增加5-10亿元收入。</p> <p>在团队整合方面，公司于2025年1月将无锡至辰收购为公司全资子公司，该公司创始人刘国辉博士多年来主要从事粉末冶金、热等静压致密化及扩散链接等方面的研发和产业化工作，具有丰富的技术开发和公司管理经验。在加入公司后，刘国辉已被公司任命为首席技术官、研发中心总经理，主导研发工作，进一步加强了公司研发团队实力。</p> |

在新产品开发方面，公司在加热器等半导体先进功能器件的研发上持续加大研发力度，目前新产品正在客户端进行验证，进度按计划进行，如验证顺利今年将实现收入。

在业务版图开拓方面，基于在半导体领域积累的丰富精密制造经验，公司将积极拓展高端医疗设备、航空方面的布局。医疗设备方面公司主要向医科达等客户供应头框架、诊疗仪、放疗设备等高端医疗设备器件和零部件；航空业务已通过航空结构件表面处理的航空质量管理体系标准认证 AS9100D，目前正在准备其它航空制造所需认证，如 NADCAP 认证、产品认证等，未来的主要客户是中国商飞及其供应商；商业航天方面已开始部分产品的表面处理业务，主要面向客户为民用火箭制造企业，目前已实现部分收入，但金额较小。

## 二、投资者主要问题回答

1、半导体上游扩产计划对公司的影响如何？

答：公司与芯片厂扩产间接关联，作为半导体设备零部件的供应厂商，公司订单与设备需求直接相关，如果上游设备需求释放预计将较快体现在公司订单上。

2、目前市场需求情况、公司订单情况如何？

答：从公司了解的市场反映看，芯片厂扩产需求比较乐观。公司已为半导体扩产预备了充足产能，目前在手订单充足，产能利用率维持较高水平。

3、请介绍公司发行可转债的情况及募投项目？

答：2026年3月4日，公司披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件。公司本次发行可转债计划募资7.50亿元，募投项目包括“半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目”、“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”、“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”及“补充流动资金”四个项目，上述项目实施将帮助公司在现有金属零部件业务的基础上，进一步向先进功能金属器件、非金属材料零部件及器件等领域拓展。目前可转债发行尚待向证券监管部门提交申请，具体情况详见公司已披露的相关公告文件，公司后续也将根据相关法律法规规定及时披露项目进展情况。